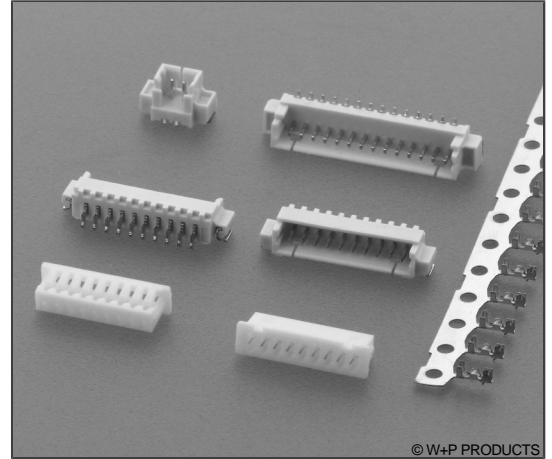


SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm, stehend/liegend SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch, Vertical/Horizontal

Technische Daten / Technical Data

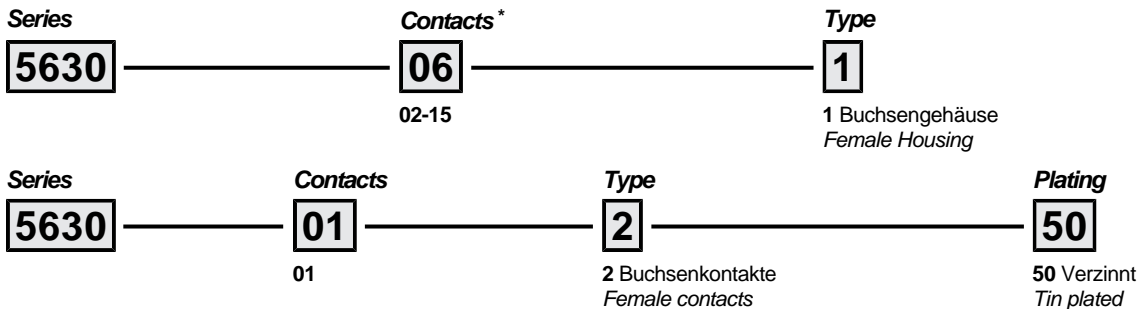
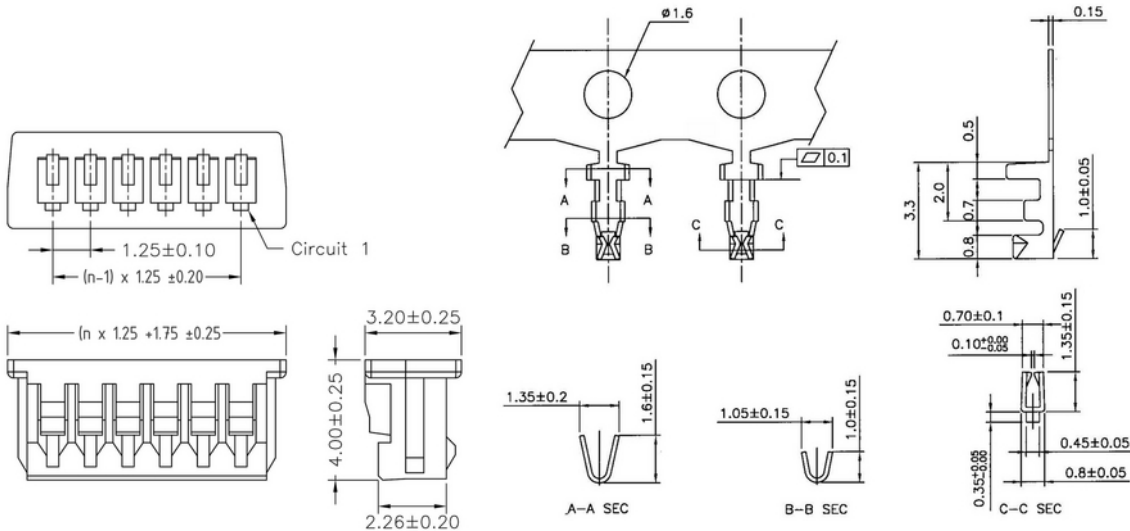
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94 V-0
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,75x0,30mm, Kupferlegierung
Contact Material	Rectangle pin 0.75x0.30mm, Copper alloy
Aderquerschnitt	AWG 32 ~ 28
Applicable wire Gauge	AWG 32 ~ 28
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
Contact Resistance	< 20mΩ
Isolationswiderstand	> 10 ⁸ Ω
Insulation Resistance	> 10 ⁸ Ω
Spannungsfestigkeit	250V _{AC}
Test Voltage	250V _{AC}
Nennspannung	125V _{AC}
Voltage Rating	125V _{AC}
Nennstrom	1A
Current Rating	1A
Temperaturbereich	-25°C ... +85°C
Temperature Range	-25°C ... +85°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren
Processing	Reflow soldering



© W+P PRODUCTS

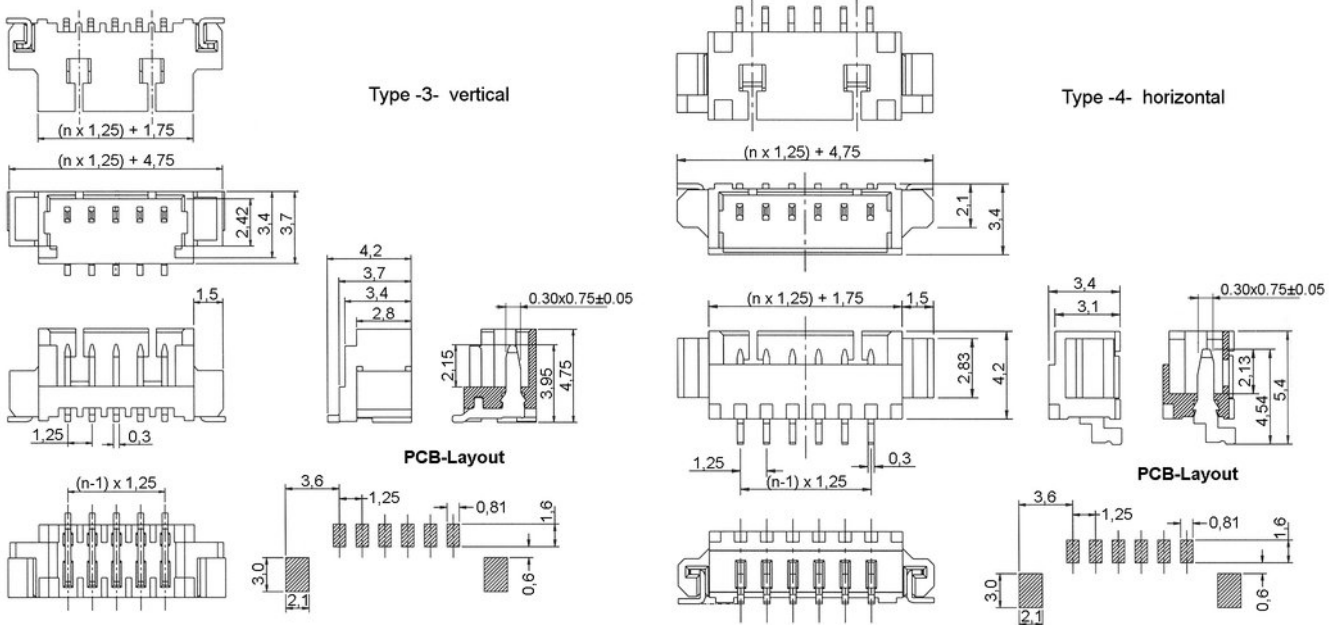
Passende Gegenstecker:
Compatible Connectors:

564



5630

SMT-Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 1,25mm, stehend/liegend
 SMT Friction Lock Headers / Crimp Housings, 1.25mm Pitch, Vertical/Horizontal



Series	Contacts*	Type*	Plating	Packaging*
5630	02 02-15	3 3 Stiftleiste stehend Vertical pin header 4 Stiftleiste liegend Horizontal pin header	50 50 Verzinkt Tin plated	TR ST TR (Option)

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Lieferformen / Packaging Options:
 ST In Stangen ohne Pick&Place-Pads / In tubes w/o Pick&Place-Pads
 TR (Option) Tape & Reel / Tape & Reel

Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

